

2016年11月28日

各 位

キャリア付極薄電解銅箔の生産体制増強

～新用途への展開、生産能力を270万m²/月体制へ～

当社（社長 西田計治）は、このたびキャリア付極薄電解銅箔について、生産能力をこれまでの月産200万m²から270万m²体制へ増強することを決定しましたのでお知らせいたします。

当社のキャリア付極薄電解銅箔「MicroThinTM」は、微細回路形成に適した1.5μm～5μmの銅箔厚みと複数種類の微細な粗化処理を組み合わせた製品です。1300mmまでの広幅でロール出荷ができる事、ならびにキャリア剥離強度の安定性に優れている事からお客様の生産性向上と工程歩留向上に寄与できるため、高くご評価をいただいております。

MicroThinTMは、主にスマートフォン向けロジック半導体である「アプリケーションプロセッサ」、および「メモリ」、「モジュール」などのパッケージ基板用に使用されておりますが、スマートフォンの高機能化によりスマートフォン用マザーボードなどのHDI（※1）プリント基板においてもMSAP（※2）による微細配線化（L/S≤30/30μm）の適用検討が急激に進んでおり、この新たな用途への展開により今後さらなる需要の拡大が予想されます。

現在の生産量は月産平均で約100万m²であり、2017年の新規追加需要につきましては、現行の設備能力で十分対応可能と考えておりますが、2018年以降も継続して需要の拡大が見込まれる事から、上尾事業所において月産140万m²体制を150万m²体制へ増強するとともに、マレーシア工場（Mitsui Copper Foil (Malaysia) SDN. BHD.）においても生産体制を増強することとし、その第一段階として、BCPライン（※3）も含めた月産60万m²体制から120万m²体制へ移行致します。

現在のパッケージ基板用途のお客様への安定した品質と十分な供給を維持するとともに、新たな用途に対しても十分な供給体制を整え、技術対応力・開発力とともにさらなるお客様との緊密な連携を取り進めてまいります。

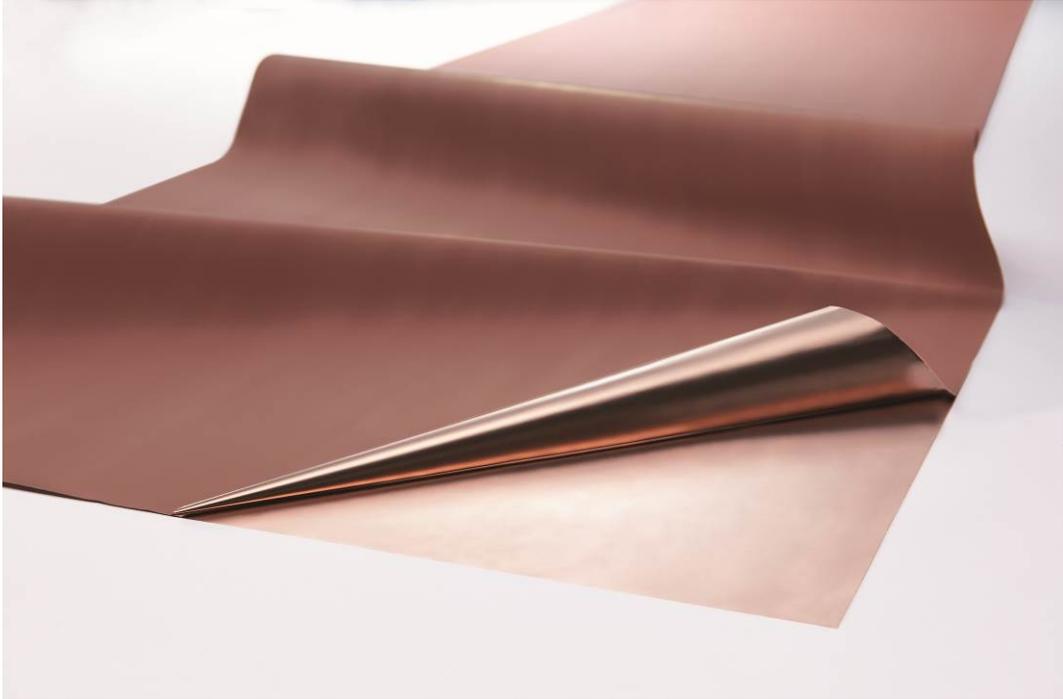
MicroThinTMの生産増強により、急速な需要増に対応するとともに、当社のスローガンである「マテリアルの知恵を活かす」のもと、さらに将来を見据えた新製品の開発を加速していく所存です。

以 上

【お問い合わせ先】

三井金属 経営企画本部 広報部 TEL 03-5437-8028 FAX 03-5437-8029

Eメール PR@mitsui-kinzoku.co.jp



キャリア付極薄電解銅箔「MicroThin™」

(補足)

※1 HDI

... 高密度実装配線 (High Density Interconnect) の略。

※2 MSAP

... モディファイドセミアディティブ法 (Modified Semi-Additive Process) の略。プリント基板の回路形成方法はサブトラクティブ法 (サブトラ) とセミアディティブ法 (SAP : Semi Additive Process) がある。サブトラは基板全面の銅箔などの導体をエッチングで非回路部分のみ除去し回路を形成する方法であるのに対し、SAP は非回路部分にあらかじめレジストを形成しておき、シード層 (パラジウムなど) のある回路部分のみをめっきで形成する方法。一方、MSAP は、SAP と同様な工法であるが、極薄銅箔を使用するため、パラジウムなどのシード層形成が不要であり、比較的容易にファイン回路を形成することが可能。

※3 BCP ライン

... 日本の拠点が稼働できない場合の BCP (事業継続計画) として、マレーシア工場内に設置した MicroThin™ のバックアップ製造ライン (2011 年 6 月 7 日リリースの「キャリア付極薄電解銅箔 MicroThin™ のバックアップ生産体制について」参照)

(ご参考)

上尾事業所について

- (1) 名称 : 機能材料事業本部 銅箔事業部 上尾事業所
- (2) 所在地 : 埼玉県上尾市
- (3) 所長 : 濱本 真
- (4) 設立 : 1967年9月
- (5) 事業内容 : パッケージ基板およびプリント配線板用銅箔の製造

Mitsui Copper Foil (Malaysia) SDN. BHD.について

- (1) 名称 : Mitsui Copper Foil (Malaysia) SDN. BHD.
- (2) 所在地 : セランゴール州、マレーシア
- (3) 社長 : 福本 浩敏
- (4) 設立 : 1989年4月
- (5) 資本金 : 330,000 マレーシアリングgit
- (6) 出資者 : 当社 100%
- (7) 事業内容 : プリント配線板用銅箔の製造